



Micron Boise, Idaho

■ Micron Technologyとは…

マイクロンは1987年に設立されたアメリカ唯一のメモリー・メーカーで先進的な半導体メモリー製品を製造し、革新的なメモリーソリューションのリーダーとして、業界で最も幅広いメモリー製品を提供しています。

各製品ラインナップにおいてインダストリアル、コンピューティング、コンシューマー、ネットワーキング、通信アプリケーションにおけるお客様の多様化したニーズにお応えしています。

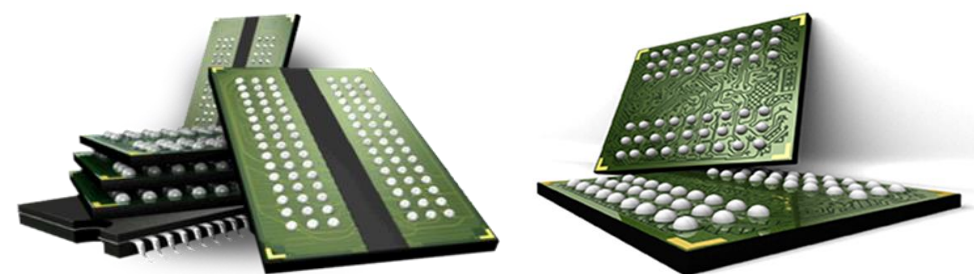
■ Micron Technology 特色

- ① NAND Flash, NOR, DRAMを扱う総合メモリーメーカーであり、幅広いラインナップを持っています。
- ② "End-to-End Solutions from Cloud to Consumer"市場ニーズに合わせ設計された製品を展開しています。
- ③ 組み込みアプリケーションを担当するビジネスユニットが長期供給製品を管理しています。
- ④ 前工程は全て自社工場で製造し、BCP対応もしています。

■ Product Lineup

● DRAM ● LPDRAM

-SDRAM
-DDR, DDR2, DDR3, DDR4
-LPDDR4



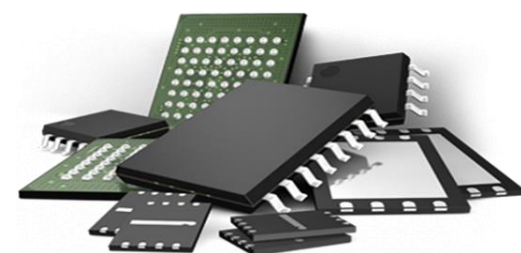
● DRAM Module

-DDR4



● NOR Flash

-Serial, Parallel
-Xccela



● SSD

-SATA
-PCIe



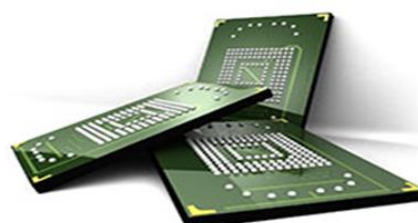
● micro SD

-SDA6.1, UHS-1



● e.MMC

-MMC v5.1



● SLC NAND

-Serial
-Parallel



Micron Technology 製品詳細

■Solution① DRAM, LPDRAM, DRAM Module

Product Lineup		Density Range	Bus Width	Performance	Voltage	Temp Range	Package Options	Product Family
SDRAM	DDR4	8-16Gb	x8, x16	2133-3200 MT/s	1.2V	-40℃ to 95℃	BGA	MT40A
	DDR3L	1-4Gb	x8, x16	1600-1866 MT/s	1.35V, 1.5V	-40℃ to 95℃	BGA	MT41K
	DDR2	512Mb-2Gb	x8, x16	800 MT/s	1.8V	-40℃ to 95℃	BGA	MT47H
	DDR	256, 512Mb	X8, x16	400 MT/s	2.5V	-40℃ to 85℃	TSOP	MT46V
	SDRAM	64-256Mb	x8, x16, x32	133-166 MT/s	3.3V	-40℃ to 85℃	TSOP	MT48LC
	LPDDR4X	4-32Gb	X32(2ch)	3733-4266 MT/s	1.1V, 0.6V	-40℃ to 95℃	200Ball BGA	MT53E
DIMM	DDR4	4-128GB	x64, x72	2133-3200 MT/s	1.2V	0℃ to 95℃	UDIMM/SODIMM, RDIMM, LRDIMM	MTA

■Solution② NOR Flash

Product Lineup	Voltage	Bus Width	Performance	Density Range	Temp Range	Package Options	Product Family
Parallel	3V	x8, x16	Async	128Mb-2Gb	-40℃ to 85℃	TSOP, BGA	MT28EW
Serial	1.8V, 3V	SPI(x1, x2, x4)	200 MHz DDR	128Mb-2Gb	-40℃ to 85℃	BGA, DFN, SOIC	MT25QU, MT25QL
Xccela™	1.8V, 3V	x1, x8	108-166 MHz	512Mb-2Gb	-40℃ to 85℃	BGA, SOIC, DFN	MT35X

■Solution③ SSD, Micro SD card, e.MMC

Product Lineup	Interface/ Bus Width	Version	Density Range	Temp Range	Package Options	Product Family
SSDs	SATA 6Gb/s	Enterprise SATA	3D TLC, 3D QLC 240GB-7.68TB	0℃ to 70℃	2.5-inch, M.2(2280)	5300 MAX/PRO/BOOT, 5210 ION
	PCIe Gen3 x4	Enterprise NVMe	3D TLC 400GB-15.36TB	0℃ to 70℃	U.2, M.2(2280), M.2(22110)	9300 PRO/MAX, 7300 PRO/MAX
	PCIe Gen3 x4	Client NVMe	3D TLC, 3D QLC 256GB-2TB	0℃ to 70℃	M.2(2280)	2300, 2210
	PCIe Gen3 x4	Industrial NVMe	3D TLC 64GB-1TB	-40℃ to 95℃	M.2(2230), BGA	2100AI
Memory cards	X4	SD6.1 UHS-I, U1/U3 A2 Class 10	32GB-1TB	-25℃ to 85℃	microSD	MTSD
e.MMC	x1, x4, x8	MMC v5.1	8-128GB MLC	-40℃ to 85℃	BGA	MTFC

■Solution④ SLC NAND Flash

Product Lineup	Voltage	Bus Width	Performance	Density Range	Temp Range	Package Options	Product Family
Serial	1.8V, 3.3V	SPI(x1, x2, x4)	Up to 133 MHz, on die (zero) ECC	1-8Gb	-40℃ to 85℃	DFN, BGA	MT29F
Parallel	1.8V, 3.3V	x8, x16	8-bit or on-die (zero) ECC	1-256Gb	-40℃ to 85℃	TSOP, BGA	

製品問い合わせ

株式会社マクニカ クラビス カンパニー
本社: 〒222-8561 横浜市港北区新横浜1-6-3 マクニカ第1ビル
TEL 045-470-9821 / FAX 045-470-9822
*製品問い合わせ
下記URLから問い合わせ頂けますようお願い致します。
<https://www.macnica.co.jp/business/semiconductor/support/contact/>
[本資料利用にあたる注意事項]
1. 本資料に掲載された製品、仕様等は作成時点(2020/05)のものであり、今後予告無く修正、変更されることがございます。
最新版資料は弊社各営業担当までお問い合わせください。